

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于对外投资进展暨全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资事项概述

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会（以下简称“苏锡通管委会”）于2023年3月21日就半导体产品、集成电路测试探针卡、集成电路陶瓷基板及器件等产品的研发、生产和销售项目签订《投资协议书》（以下简称“原投资协议”）和《投资补充协议》，并在苏锡通科技产业园区设立全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“项目公司”或“南通强一”）实施整个项目的投资、建设和运营。该项目分为一期和二期，为优化资源配置，公司于2025年12月10日召开了第二届董事会第五次会议、于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与苏锡通管委会签署〈投资协议书（二）〉的议案》，同意公司将原投资协议约定的二期项目分成2-1、2-2期逐步推进实施，并与苏锡通管委会就投资建设2-1期项目签订《投资协议书（二）》。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议书（二）暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-011）。

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）南通探针卡研发及生产项目为上述一期项目的构成主体。公司在南通探针卡研发及生产项目实施过程中，

基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量，对原规划的手动及半自动生产线方案进行了系统性升级，拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造体系。与此同时，全自动生产线及智能物流系统的引入，对厂房在空间布局、层高承载、结构强度、电力容量、洁净环境、信息化接口及安全冗余设计等方面提出了更高要求，为保障自动化设备稳定运行及系统集成效果，公司需在原有规划基础上，对厂房结构、机电系统及相关配套进行同步强化建设。公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第六次会议、于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意实施主体增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，南通探针卡研发及生产项目投资总额将由人民币 120,000.00 万元增加至人民币 246,770.00 万元。基于南通探针卡研发及生产项目投资额度的调整，2026 年 9 月，公司与苏锡通管委会达成一致，同意将项目公司注册资本由原投资协议约定的 5 亿元增加至 6 亿元，并补充签订《投资协议书（三）》，本事项已经公司总经理办公会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订〈投资协议书（三）〉暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-075）。

二、对外投资事项进展

近日，南通强一已完成工商变更登记手续，并取得了南通市经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

名称：强一半导体（南通）有限公司

统一社会信用代码：91320693MACDTBBN78

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周明

注册资本：60000 万元整

成立日期：2023 年 04 月 12 日

住所：江苏省南通市苏锡通科技产业园区海滨路 10 号

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日